



中华人民共和国国家标准

GB/T 14663—93

塑封模具技术条件

Specification of plastic packaging mould

1993-10-16 发布

1994-07-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

塑封模具技术条件

GB/T 14663—93

Specification of plastic packaging mould

1 主题内容与适用范围

本标准规定了塑封模具基本性能、装配技术条件、检测与验收规定、包装、运输、贮存等。

本标准适用于塑料封装的集成电路、半导体分立器件、元件等塑封模具。封装材料为热固性塑料,如改性环氧树脂、硅酮塑料等。

2 引用标准

GB 191 包装储运图示标志

3 基本性能

3.1 模具封装出的产品符合产品图纸和技术要求。

3.2 模具符合产品塑封工艺要求。

3.3 模具成型部分和浇注系统的零件材料,热处理硬度应符合表 1 规定。允许采用性能和质量高于表 1 规定的其他材料。

表 1

零件名称	零件材料		硬度 HRC	备注
	牌号	标准代号		
成型镶件、浇注镶件 浇道板、镶件座	9Cr18	GB 1220	54~58	
	CrWMn	GB 1299	54~58	镀硬铬
	Cr12MoV		58~61	
	Cr12Mo ₁ V ₁		58~61	
材 料	Cr12MoV	GB 1299	60~64	镀硬铬
注射头	Cr12MoV	GB 1299	58~61	
	PTFE	ZB G33 002		

3.4 表面粗糙度

3.4.1 成型部分和浇注系统工作面的表面粗糙度应符合表 2 规定。

表 2

μm

名 称	R _a
浇道、浇口	0.1
排气槽	0.1